



Tagesordnung

Thema: 57. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **Montag, 25. April 2016, 10.00 Uhr**

Ort: Messezentrum Nürnberg, **NCC-Ost**, Saal Oslo

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Aktuelle IPC-Richtlinien
Herr Dingler, FED, Berlin
- 3 10:30 Uhr
Einpresstechnik in Cu/OSP-Oberflächen - eine Variante mit Zukunft?
Herr Dr. Jaeckle, Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen
- 4 11:10 Uhr
Aktuelle Anforderungen und Herausforderungen des Microelctronic Packagings
Herr Schneider, First Sensor, Dresden
- 5 11:50 Uhr
3D-Montageprozesse zum Aufbau von mehrdimensionalen Magnetfeldsensoren
Herr Barth, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Stuttgart

- 6 12:30 Uhr
Mittagessen
- 7 13:30 Uhr
Die Zuverlässigkeit von Lötverbindungen in Abhängigkeit ihres Porenanteils
Frau Rauer, Hochschule Aschaffenburg, Aschaffenburg
- 8 14:10 Uhr
Beschleunigtes Testen in der Leistungselektronik
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 9 14:50 Uhr
Kaffeepause
- 10 15:00 Uhr
ECAD-Trace-Mapping für Leiterplatten und Packages
Herr Iberer, CADFEM GmbH, Grafing
- 11 15:40 Uhr
Analysis of sintered silver joints for high temperature applications
Herr van Dijk, Fraunhofer IZM, Berlin
- 12 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr